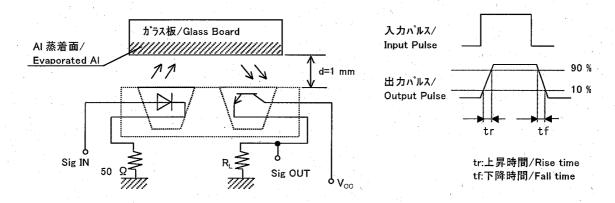
							· · · ·	Sheet	No. 1/1
製品規格/PRODUCT	SPECIFICATIO	N	DES	GNED BY	CHECI	KED BY	CHECKED E	3Y APPRO	OVED BY
品種名/TYPE NUMBE	R:CNB10010	D□L *1	A-N	la kano	J. hat	egowa	76/pm	\$ 5.M	ijn
種別/Type	反射型フォトセ	zンサ/Pho	to Interrupter		-	ý		· ·	
用途/Application	物体検知、無	接点スイッ	チ/Object Det	ection, Co	ontactle	ss SW.			
構造/Structure			ヾ(非干渉性)・S ting Diode(Non				to Transisto	or	·····
接続/Connection 外形/Out line	附図/Attach			-					
絶対最大定格		(注 1)(Note		N.		1)(Note1)		· · ·	
Absolute Maximum	V_{R} I_{F} 6 50	-	I _c V _c 20 3!	_{eo} V _{eo} 5 6		Р _с 75	Topr -25∼+85	Tst -40~	-
Ratings	V mA	w mW		V		mW	°C		C
Ģ	電気的·光学的特	寺性/Elect	rical-Optical C	haracteris	tics (⁻	Гa=25 °C∶	±3 ℃)	÷ .	
項目/Item	略号	通行	条件/Measuri	Canditi		標準値	許容値	∕Limit	単位
項日/ Item	Symbol	川に	未什/ Measuri	ng Conditio	on	Тур.	Min.	Max.	Unit
入力特性/Electrical C	haracteristics -	- Input Diod	le			-	- I ac		
順電圧/Forward Voltag	ge V _F	I _F =20 mA				1.2		1.4	V
逆電流/Reverse Curre	nt I _R	V _R =3 V	· · ·			-		10	μA
出力特性/Electrical C	haracteristics -	- Output Tr	ansistor					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
暗電流/Collector to Emitter Dark Curren	t I _{CEO}	V _{CE} =20 V	·		-			100	nA
伝達特性/Electrical C	haracteristics -	- Coupled			I			· ·	
コレクタ出力電流/ Collector Current	Ic	V _{cc} =2 V, d=1 mm	I _F =4 mA,R _L =100)Ω (注 2)(No	ote2)		23 (注 4)(160	μA
 暗電流/Dark Current	I _D	V=2 V	I _F =4 mA,R _L =100					100	nA
応答時間/Switching Ti	tr		$I_c=0.1 \text{ mA, R}_L=100$	1 000 Ω		30		100	μs
コレクタ・エミッタ飽和電圧/	tf V _{CE}	I = 20 m A	I =0.1 mA	(注 3)()	Note3)	40	· · ·	0.4	
Saturation Voltage	(sat)	I _F -20 mA	, I _c =0.1 mA			· · ·		0.4	V
(注 1)入力側及び出力 (Note1)Above 25 ℃ ar					f 1.0 mV	V∕°C.			
(注 2)出力電流測定方 (Note2) Electrical Char					vaporat				
	acteristics-Cou 面/	カ [・] ラス板/G	lass Board		<u></u>	ion.			
(Note2) Electrical Char AI 蒸着i	acteristics-Cou 面/				vaporat	ion.			
(Note2) Electrical Char Al 蒸着i	acteristics-Cou The Al I F	カ [・] ラス板/G	lass Board		<u></u>	ion.			
(Note2) Electrical Char AI 蒸着i	acteristics-Cou 面/	カ [・] ラス板/G	lass Board		<u></u>	ion. n			
(Note2) Electrical Char AI 蒸着i	acteristics-Cou The Al I F	カ [・] ラス板/G	lass Board			ion. n			
(Note2) Electrical Char Al 蒸着i <u>Evapora</u>	acteristics-Cou I / I / I / I / I / I / I / I / I / I /	カ [・] ラス板/G	lass Board			ion. n			

Sheet No. 2/12

製品規格/PRODUCT SPECIFICATION

品種名/TYPE NUMBER: CNB10010□L *1

(注 3)(Note3) 応答時間測定回路/Switching Time Measuring Circuit.



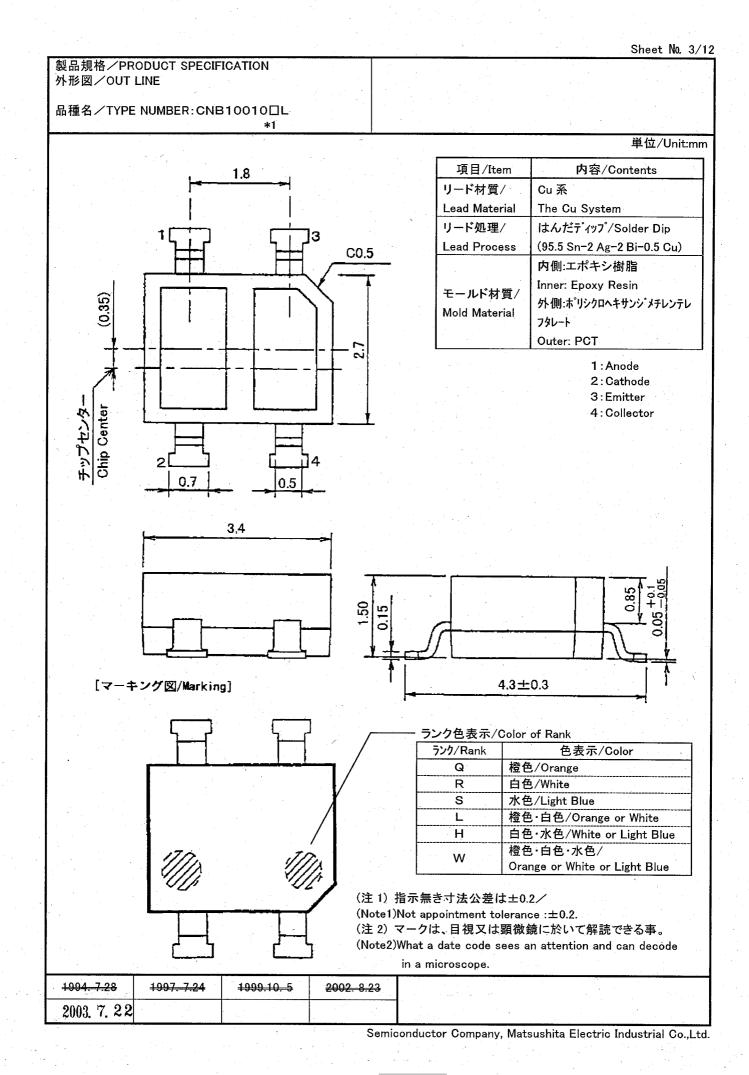
(注 4)(Note4)Ic ランク分類/Ic Rank classification

*1 Code=ランク/Rank	Ic(μA)	色表示/Rank Color	品名 Type Number
Q	23~ 50	橙色/Orange	CNB10010QL
R	41~ 90	白色/White	CNB10010RL
S	74~160	水色/Light Blue	CNB10010SL
L	23~ 90	橙色 白色/Orange or White	CNB10010LL
Н	41~160	白色・水色/White or Light Blue	CNB10010HL
W	23~160	橙色·白色·水色/ Orange or White or Light Blue	CNB10010WL

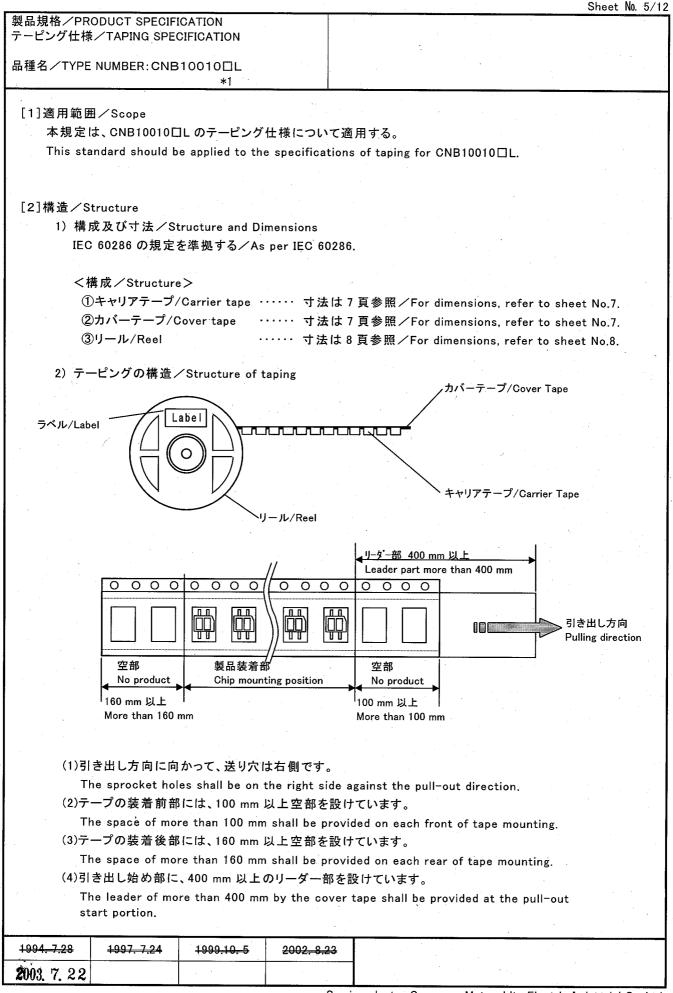
(注 5)(Note5)入出力は電気によって行われます。/Input and output are practiced by electricity.

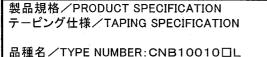
(注 6) 本製品は、耐放射線を考慮した設計ではありません。 (Note6)This device is designed by disregarding for radiation.

	· · · ·					
1994. 7.28	1997. 7.24	1999.10. 5	2002. 8.23	and and a second se	•	
2003. 7. 22						



					Sheet No. 4/12
	ODUCT SPECIF 意事項/CAUTIC		NG		
局種名/TYPE	NUMBER:CNB	810010□L *1			
1)リフロー 下図の第		願います。/ S		dable conditions.	
[リフロ -	─条件:1回迄/	Soldering Time	: Less than 1 t		
· · · · ·			Max 240	c 235 ℃±5 ℃ 11 s 以内 Within 11 s at 235 ℃±5 ℃	
		19 - Contra de C		200 °C 40 s 以内	_
	150 ℃±10 ℃	予熱/Pre	heat	Within 40 s at 200 °C	
н		90 s±3	30 s		
			•		
, · · · · ·	ر ۲		177411 /7		
2)手はん	P极表面 だ付け/Iron So		LC PEN. / le	mperature profile on printed board.	
・コテ先	温度 300 ℃、2	2 秒以内を基本		1度が 300 ℃以上となるときは、時間	を短縮
	うにして下さい。 んだコテは温度			ることを推奨致します。	
	rature : less th				
Time Solder	: less ring iron with to	than 2 s emperature con	trol should be	performed.	
	and the second se			いようにご配慮下さい。	
ありま	す。又、はんだ作	けけ直後に素子	の取り付け修正	長子の破壊が発生する可能性が 、基板のそり修正を行った場合も同様	兼です。
	取り付けた製品 t give mechanic			モけて下さい。)	· · · · ·
If adju	-	e for the mount	ing of device, s	tress will be given to the element	which
	∠[Cleaning]				
	製品単体の洗浴		- 0		
	o the washing a については、アノ			ng.	
	re recommende テース本体を滚		で下さい ケーフ	内への溶剤の残留等により特性及び	《合志사 ~ 망鄕
を及ぼす	場合があります。	o			加品积住へ影音
	rine solvent wh 浄は、素子の構			epoxy and chip die.	
	on't be cleaned			0	
[その他]/[
				常電圧が加わらないようご配慮下さい shoot voltage, under shoot voltage,	
・本資料に	記載されておりる	ます製品は、標≥	隼用途;一般的	電子機器(事務機器,通信機器,計測	則機器,家電
				な品質,信頼性が要求され、その故 ある用途;特定用途(航空,宇宙,交	
燃焼機器	,安全装置など)にご使用をおす	考えのお客様及	び、弊社が意図した標準用途以外で	
	様は、事前に弊 ce is designed			ronic equipment's (Office equipmen	ıt.
Communi	cation equipme	nt, Instrumenta	tion equipment.	Home electrification product etc).	
				d for specific uses(Flying·Space Safety equipment's etc) where faul	t of
	in danger of hu	uman life, user : I		atsushita Electronics Corporation.	
1994. 7.28	1996. 3.26	1997. 7.24	1999.105		
2002. 8.23	2003. 7. 22				





品裡名/IYPE NUMBER: CNB10010山L *1

[3] 数量及び包装表示/Quantity and indication on the package.

1)テーピング数量/Taping quantity

1 000 個/1 巻を標準装着数量とします。

The standard quantity shall be 1 000 pcs/reel.

3 巻を所定のカートンに梱包します。

3 reels shall be packed in the specified carton box.

2)表示/Indication

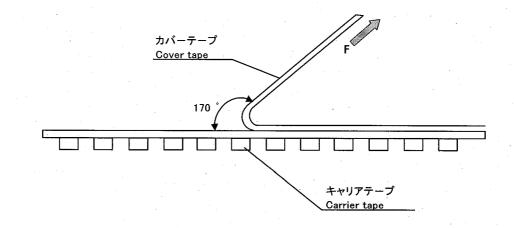
リールに品名・ランク・数量・製造番号(略番号)を記載します。

The type, rank, quantity, serial No. shall be shown on one side of the reel.

[4]機械的特性と仕様/Mechanical characteristics and specifications

1)カバーテープの剥離強度/Peeling strength of cover tape F=0.2 N ~ 0.7 Nとします。(テンションゲージで測定) F=0.2 N ~ 0.7 N (measured by tension gage)

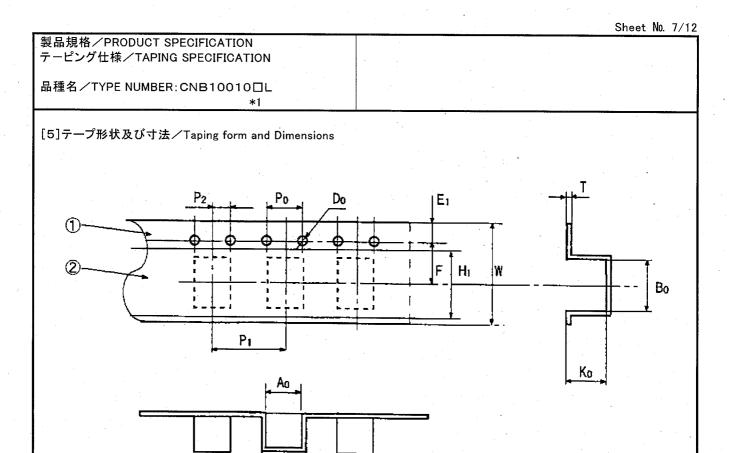
(注) 剥離時にテープが裂けないこと。 (Note)Tape should not be burst by peeling.



2)仕様/specifications

- (1) 装着済みテープを半径 30 mm で曲げても製品の脱落、テープの損傷等なきこととします。
 When the tape is bent to radius 30 mm, products do not fall down from the tape and tape doesn't get any damage.
- (2) カバーテープの剥離時、製品がカバーテープに付着しないこととします。
 During the peeling, products do not fix to cover tape.
- (3) テーピングされた製品の反転、逆向き、歯抜けはなきこととします。
 - As a rule the product taped shall not be turned upside down, reversed or partial absence in product arrangement.

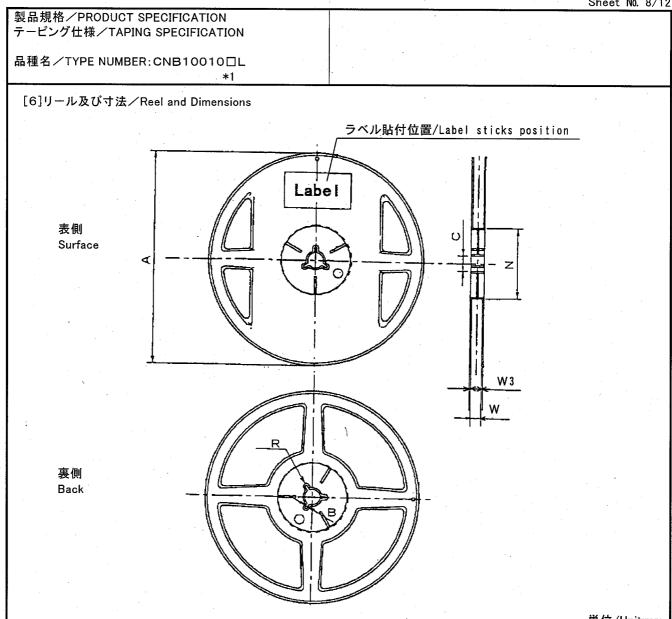
1994. 7.28	1997. 7.24	1999.10. 5	2002. 8.23	······································	
2003. 7. 22	· ·		·		



①キャリアテープ/Carrier tape ②カバーテープ/Cover tape

					単位/Uni										
÷	項目		照合文字	寸法	備考										
	Item		Symbol	Dimensions	Remarks										
	縦/Ler	ngth	A0	4.10±0.1											
製品挿入凹み角穴	横/Wic	lth	B0	4.80 ± 0.1											
Dented square	深さ/D	epth	К0	1.95±0.2											
hole for product				8.0±0.2	累積誤差±0.2 max/10 ピッチ										
insertion	ピッチ/	Pitch	P1		Accumulated error $\pm 0.2 \text{ max}/10$ pitches										
	直径/[Diameter	D0	1.55±0.1											
送り穴 Sprocket hole	ピッチ	'Pitch	P0	4.0±0.1	累積誤差±0.2 max/10 ピッチ Accumulated error ±0.2 max/10 pitches										
	位置/F	Position	E1	1.75±0.1											
中心線間距離	縱方向	/Longitudinal	P2	2.0±0.1											
Center-to-center distance	横方向/Traverse		横方向/Traverse			横方向/Traverse		横方向/Traverse		横方向/Traverse	方向/Traverse	向/Traverse	F	5.5±0.1	
カバーテープ	幅/Wid	lth	· H1	9.5±0.1											
Cover tape	材質/N	Naterial	ホ [°] リエステル/P	olyester	帯電防止処理有/Anti-static										
キャリアテープ	幅/Wid	lth	W	12.0±0.3											
Carrier tape	厚さ/T	hickness	T	0.3±0.1											
	材質/№	laterial	ポリスチレン/P	S	帯電防止処理有/Anti-static										
004 7 00	0.0.00		1000.10	<u> </u>	and Market and Annual Annua										
994. 7.28 19 9	6. 3.26	1997. 7.24	1999.10	\$											
002. 8.23 2003.	7.22														





,					.*		/ 単位/Unit:mm	
		1	項目		照合	寸 法	備考	
			Item		Symbol	Dimensions	Remarks	
		直径/Diam	直径/Diameter			180 + 0 - 3.0		
	フランジ	厚さ/Thick	iness		W3	1.2±0.3		
	Flange		両フランジの内側間隔 Distance between flanges			13.0±0.3		
		外周直径/	Outer diameter		N	$60^{+1.0}_{-0}$		
	ハブ	スピンドル:	穴の直径/Spindle	e hole diameter	С	13.0±0.2		
	Hub	キー溝	幅/Width		В	2.0±0.5		
		Keyway	角丸み/Rad	角丸み/Radius at corner		1.0		
	材質/Materia	al	ポリスチレン	v/PS	帯電防止処	理有/Anti-static		
	品名等の表示	-	フランジのド	ἡ側に表示/Tobep	printed on one	side of flange.		
		the name etc.	品名·数量·	製造番号等を記載	·			
		the name etc.	Name, Quar	ntity, Serial No. etc	. to be shown.			
	·							
4	1994. 7.28 1997. 7.24 1999.10. 5 2002. 8.23					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

					· .
	· · · ·	Semicon	ductor Company	, Matsushita Electric	Industrial Co.,Ltd.

2003. 7. 2.2

Sheet No. 9/12

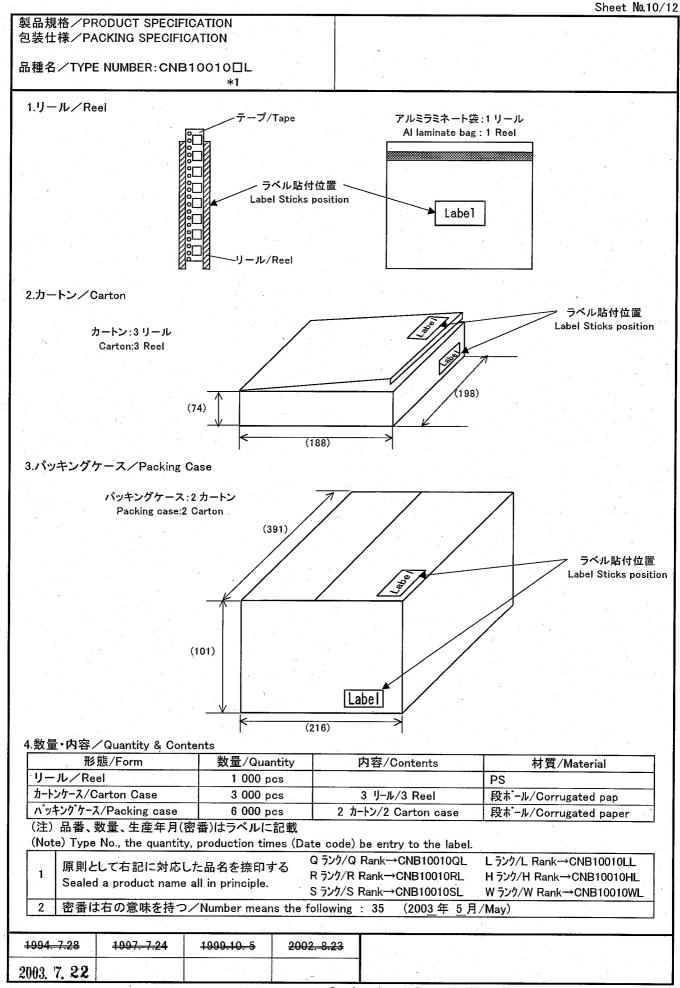
製品規格/PRODUCT SPECIFICATION 信頼性保証基準/RELIABILITY GUARANTEE CRITERION 故障判定基準/FAILURE CRITERION 品種名/TYPE NUMBER: CNB10010口L

*1		
言頼性保証基準は、(MIL−STD−19500H LTPE		
eliability Guarantee Criterion(MIL-STD-195	500H LTPD 15 %)	
項 目/Item	条 件/Test Conditions	結果/Result
実用動作試験/Operating Test	Ta=65 °C,I _F =23 mA, Vcc=10 V,t=1 000 h	0/15
高温高湿動作試験/Temperature Humidity Operating Test	Ta=60 °C,RH=90 %, I _F =26 mA, t=500 h	0/15
高温バイアス(BT)試験/High Temperature Bias Operating Life Test	Ta=85 °C,V _{cc} =28 V,t=1 000 h	0/15
高温高湿バイアス(THB)試験/Temperature Humidity Bias Operating Life Test	Ta=60 °C,RH=90 %, V _{cc} =28 V,t=500 h	0/15
高温高湿保存試験/High Temperature Humidity Storage Life Test	Ta=60 °C,RH=90 %,t=1 000 h	0/15
高温保存試験/High Temperature Storage Life Test	Ta=100 °C,t=1 000 h	0/15
低温保存試験/Low Temperature Storage Life Test	Ta=−40 °C,t=1 000 h	0/15
熱衝擊試験/Thermal Shock Test	Ta = 100 °C ~ −40 °C , 10 Cycle (5 min) (5 min)	0/15
温度サイクル試験/ Temperature Cycle Test	Ta = 100 °C ~ 25 °C ~ −40 °C , 20 Cycle (30 min) (5 min) (30 min)	0/15
リフローはんだ耐熱試験/ Reflow Soldering Heat Resistance Test	SheetNo.4/12 の条件で1回通し SheetNo.4/12 Less than 1 time.	0/15
はんだ付け性試験/ Solderability Test	前 処 理:Ta=85 ℃,RH=85 %,t=16 h 試験温度:230 ℃,5 秒,フラックスあり Solder :230 ℃,t=5 s with flux	0/15
落下試験/Drop Test	高さ1 m より厚さ3 cm 以上の楓板上自然落下3回 Distance of dropping : 1 m Drop the device on the maple board 3 times	0/15
リード線引張り試験/ Terminal Strength Test	静荷重 5 N,30 秒間 Weight due to the terminal:5 N,t=30 s	0/15
リード線折曲げ試験/ Terminal Bend Test	静荷重 2.5 N,90 度折曲げ,2 回 Weight due to the terminal:2.5 N, Bend the terminal at right 90 angle to back, 2 times	0/15

故障判定基準/Failure Criterion

項 目/Item	記号	判定基準(注)/	Criterion(Note)	単位	
項 日/Item	Symbol	下限/Lower Limit	上限/Upper Limit	Unit	
電気的特性	∕Electrical C	haracteristic	-		
コレクタ出力電流変化率/Collector Current	⊿Ic	50	150	%	
暗電流/Collector to Emitter Dark Current	I _{CEO}	—	U × 2.0	nA	
順方向電圧/Forward Voltage	V _F		U × 1.2	V	
外観	,他/Appeara	nce, etc		I	
外 観/Appearance	外形規格に準ずる/According to visual spec				
錆•変色 /Rusting, Discoloring	錆・変色(リード部)なきこと/No rusting, discoloring (Lead)				
はんだ付性/Solderability	浸漬部分に 95 %以上はんだが付く事 The Solder must stick to steeped part more than 95 % of the face area.				

(注入Note) 0.协务成旧工政值/ Opper Initial standard							
1994. 7.28	1997. 7.2 4	1999.10. 5	2002. 8.23				
2003. 7. 22						•	



Sheet No.11/12

製品規格/PRODUCT SPECIFICATION

品種名/TYPE NUMBER: CNB10010□L

[製品保管/Storage]

- ・製品の搬送中及び保管中の吸湿を避けるため、シリカゲル入りのアルミラミネート袋による防湿 包装を行っております。
- 吸湿が進行するとシリカゲル内のインジケータが変色(青色からピンク色に)しますので注意して ください。
- アルミラミネート袋開封後は製品の吸湿が急速に進行し、最悪の場合リフロー時の熱ストレスで特性不良が発生しますので、一袋毎に開封し速やかにリフローを完了するよう徹底してください。
- •To prevent humid absorption while transporting or storing the product, humidity proof packing is made using a AI laminate bag(with a silica gel).

Pay attention because indicator inside a silica gel change color from blue to pink. Be complete to unseal every 1 bag and carry out reflow soldering promptly, because moisture absorption of a product advances rapidly and characteristic defectiveness occurs by a heat stress of reflow soldering in the case that it is worst.

・一旦開封した製品を再度包装し使用することは避けて下さい。
 ・Avoid to pack and use the product that unsealed at first once again.

*1

・万一、アルミラミネート袋開封後から下記保管条件で 72 時間経過した製品は使用しないで下さい。
 Do not use the product that passed for 72 hours after under the following condition a rare possibility, aluminum laminate bag unsealing.

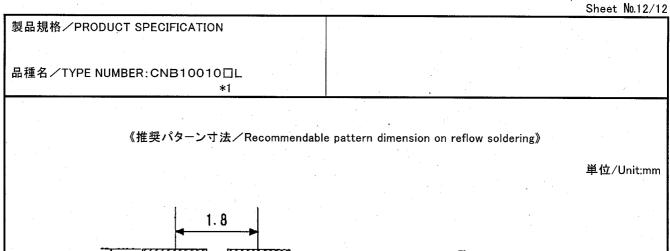
※保管条件/ Storage condition 温度:5 ℃~35 ℃、湿度:45 % ~ 75 %以下 5 ℃~35 ℃ of temperature and under 45 % ~ 75 % of humidity

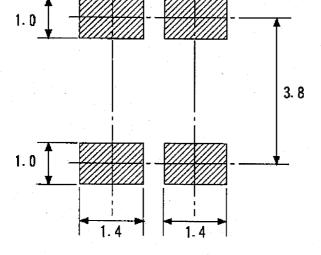
[製品の保管期間/Storage limit of product]

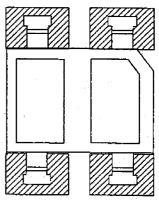
・製品の保管期間につきましては、テーピング寿命も考慮し1年以内に使用されることを推奨致します。 ・It is recommended the product be used within a year.

※保管条件/ Storage condition 温度:5 ℃~35 ℃、湿度:45 % ~ 75 %以下 5 ℃~35 ℃ of temperature and under 45 % ~ 75 % of humidity

	1				
1994. 7.28	1997. 7.2 4	1999.10. 5	2002. 8.23		
2003. 7. 22			· .		







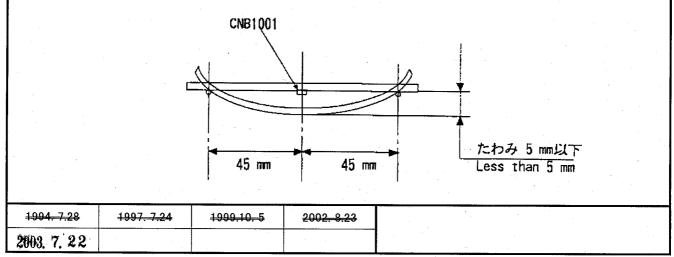
(注/Note)

1.フロー方式での使用はお避け下さい。

It is generally impossible to use by flow.

2.基板のたわみ

It bends of board.



单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>Panasonic(松下)